

**VIA Technologies, Inc.**

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan

Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、エッジ AI デバイスの市場投入時間を短縮する VIA SOM-9X35 スターターキットを発表

2022 年 2 月 18 日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、台湾時間の 2 月 17 日、小売業や商業、産業用のエッジ AI デバイスの市場投入時間を短縮する「VIA SOM-9X35 スターターキット」を発表いたしました。

「VIA SOM-9X35 スターターキット」の特徴は以下のとおりです。

- ・小売業や商業、産業用向けスマートアクセスコントロールシステム、自動販売機、情報キオスク、POS デバイス、目視検査システムなどの開発をスピードアップ
- ・モジュール、キャリアボード、ディスプレイ、タッチパネル、カメラモジュールが一体となったパッケージを提供することで、デバイス開発のコストと開発時間を削減
- ・2.0GHz 動作の MediaTek i350 Cortex-A53 クアッドコア SoC を採用し、専用 APU (AI プロセッサ) と DSP (デジタルシグナルプロセッサ) を搭載することで、リッチな視覚・音声 AIOT アプリケーションを実現



クアッドコアの MediaTek i350 プロセッサを搭載した柔軟な高性能プラットフォームとなる「VIA SOM-9X35 スターターキット」には、7 型 LCD パネルとタッチパネルディスプレイ、13M ピクセル HD カメラモジュール、デュアルスピーカーとマイクが搭載されており、デバイス開発を飛躍的に高められる密に統合されたパッケージを提供します。また、デュアルバンドの 802.11ac Wi-Fi、イーサネット、Bluetooth 5.0 に加え、オプションで 4G にも対応しており、さまざまな用途にあわせ、シームレスな接続性を提供します。

「AI がますますエッジに移行する中、顔認識、物体認識、ジェスチャー認識、動作認識などのインテリジェントなビジョン・アプリケーションを実行するためのパワーと柔軟性を備えた、パワフルで手頃な価格のエッジ・デバイスに対する需要が急激に高まっています」と VIA Technologies, Inc.の国際マーケティング

VIA、エッジ AI デバイスの市場投入時間を短縮する VIA SOM-9X35 スターターキットを発表

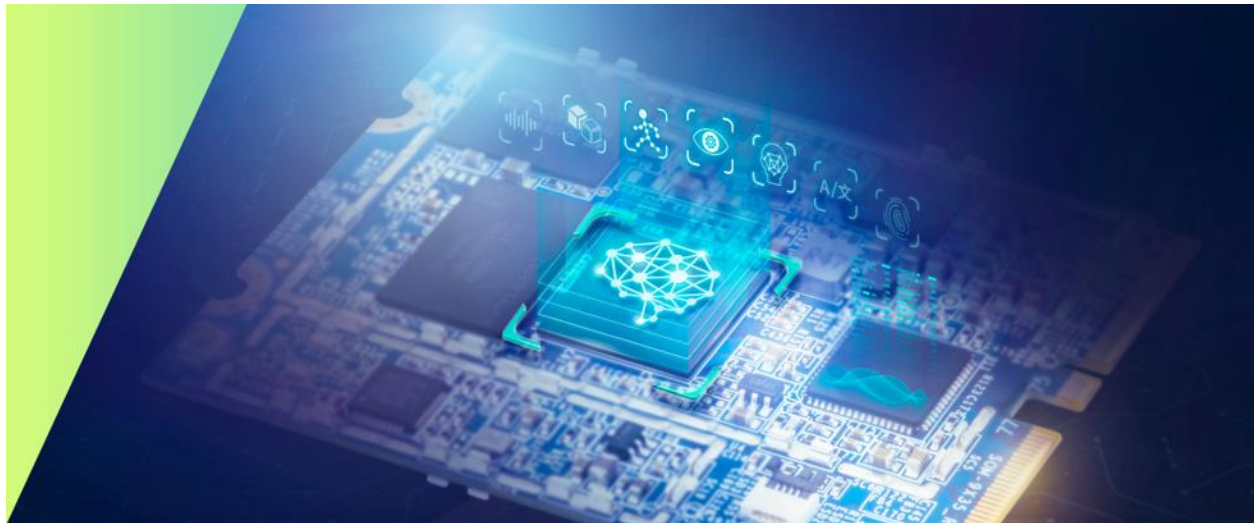
2/3

担当 VP であるリチャード・ブラウンは述べています。また、「VIA SOM-9X35 スターターキット」は、コアコンピュータ、ビデオ、ディスプレイの各コンポーネントを単一パッケージに統合することで、お客さまがこれらの急成長する市場機会を利用して革新的なデバイスの開発を迅速に開始することを可能にします」と語ります。

VIA SOM-9X35 スターターキット

VIA SOM-9X35 スターターキットは全世界で販売されます。本スターターキットは、以下の主要コンポーネントで構成されています。

- ・ AI、ML アプリケーション向け 2.0GHz MediaTek i350 Cortex-A53 クアッドコア SoC を搭載した VIA SOM-9X35 モジュール
- ・ HDMI、MIPI DSI、MIPI CSI、デュアルバンド 802.11ac Wi-Fi、10/100Mbps イーサネットポート、Bluetooth 5.0 を含む豊富な I/O および接続機能を備えた VIA VAB-935 3.5 インチ SBC フォームファクターキャリアボード
- ・ 7 型 1024 × 600 ピクセル MIPI 液晶パネル + タッチパネルディスプレイ
- ・ 13M ピクセルカメラモジュール
- ・ 2 つのスピーカーとマイク



VIA SOM-9X35 は、単体モジュールとしてだけでなく、VIA VAB-935 キャリアボードと組み合わせて購入することもできます。また、市場投入までの時間を短縮し、開発コストを最小限に抑えることを可能にする、ハードウェアおよびソフトウェアのカスタマイズサービスも充実しています。

VIA SOM-9X35 の詳細は下記をご覧ください。

<https://www.viatech.com/ja/products-jb/boards-jb/modules/via-som-9x35/>

本プレスリリースに関連する画像はこちらからダウンロードいただけます。

<https://www.viagallery.com/via-som-9x35/>

VIA、エッジ AI デバイスの市場投入時間を短縮する VIA SOM-9X35 スターターキットを発表

3/3

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、交通、産業およびスマートシティアプリケーション向けの革新的なスマートソリューションを通じ、ビジネスを高度な AI、IoT、コンピュータービジョンテクノロジーに接続するための国際的なリーダーです。台湾・台北に本社を置く VIA のグローバルネットワークは、米国、アジア、ヨーロッパのハイテクセンターとリンクし、世界をリードするハイテク、産業、運輸会社の多くを含む顧客に広がっています。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。